Silicium Solarzellen: Status Quo und Entwicklungen für die Zukunft



Dr. Martin Hermle, Dr. Stefan Glunz

Fraunhofer Institut für Solare Energie Systeme ISE

77. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung

Dresden 4.-8. März 2013

Agenda

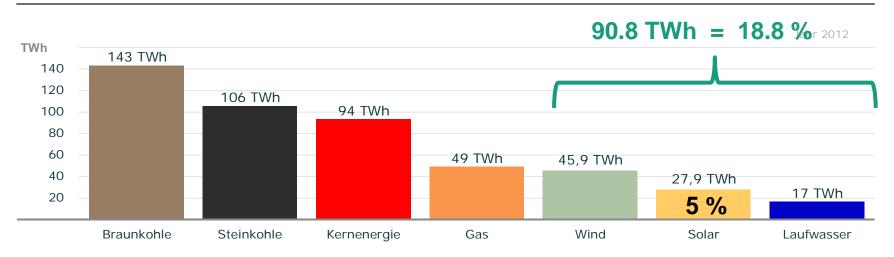
- Aktuelle Status der Photovoltaik
- Siliciumsolarzellen: State-of-the-art Technologie
- Technologien zur Steigerung des Wirkungsgrades
- Zusammenfassung

Agenda

- Aktuelle Status der Photovoltaik
- Siliciumsolarzellen: State-of-the-art Technologie
- Technologien zur Steigerung des Wirkungsgrades
- Zusammenfassung

Nettostromerzeugung 2012

Nettostromerzeugung

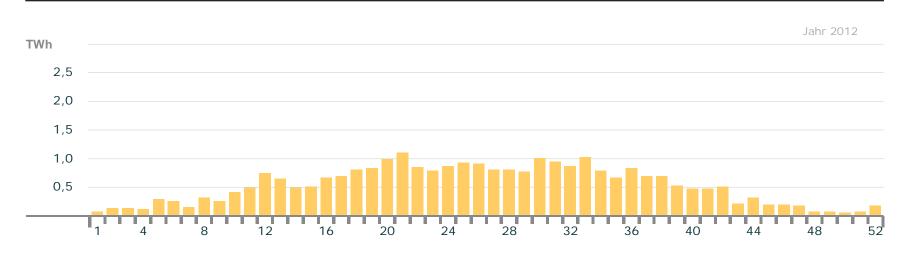


- Datenquellen:
 - Januar bis Oktober: Statistisches Bundesamt
 - November und Dezember: EEX mit Korrekturfaktoren

Grafik: B. Burger, Fraunhofer ISE; Daten: Statistisches Bundesamt, Leipziger Strombörse EEX

Wöchentliche Produktion Solar

Wöchentliche Produktion Solar

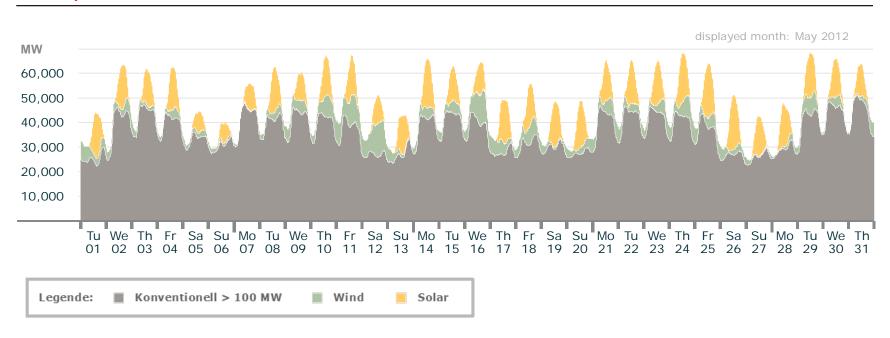


- Die maximale wöchentliche Stromproduktion erzeugten Solaranlagen bisher in Kalenderwoche 21 mit 1,1 TWh
- Die minimale wöchentliche Produktion betrug 0,06 TWh in Kalenderwoche 50

Grafik: B. Burger, Fraunhofer ISE; Daten: Leipziger Strombörse EEX

Nettostromerzeugung in Deutschland: Mai 2012

Actual production

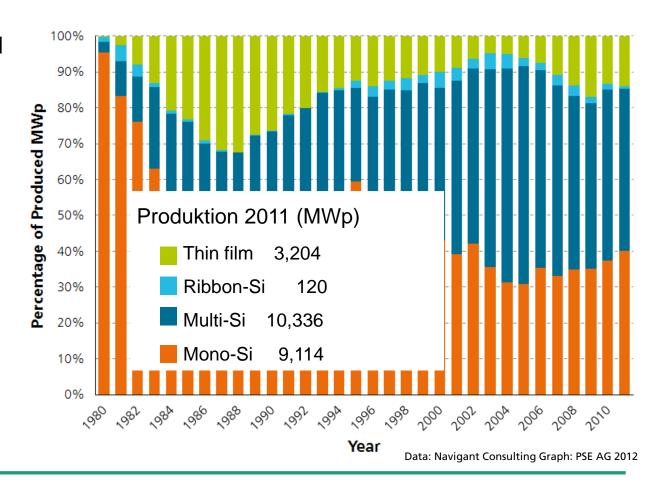


Photovoltaik produziert dann Strom, wenn die Lastspitzen am größten sind

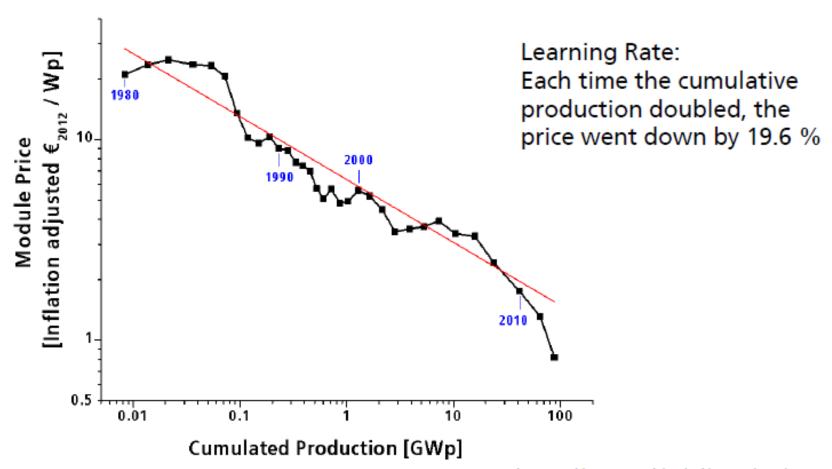
Graph: Bruno Burger, Fraunhofer ISE; Data: EEX Transparency Platform /

Anteil der unterschiedlichen Technologien

- PV Produktion 201123 MWp
- Kristallines Silicium hat einen Marktanteil von 85 %
- Silicium dominiert den PV Markt seit über 30 Jahren



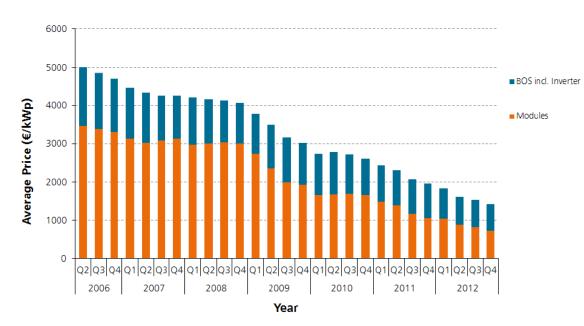
Price Learning Curve (all bulk PV-Technologies)



Data: Navigant Consulting; EUPD module price (since 2006) Graph: PSE AG 2012

Preisentwicklung 2006 bis 2012

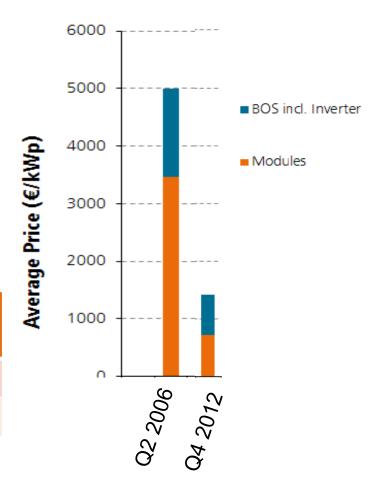
- Anlagenpreise in den letzte7 Jahren um 70 % gefallen
- Aktuelle Anlagenpreise Schlüsselfertig ca.
 1400 €/kWp
- Stromgestehungskosten in Süddeutschland~ 0,13-0,17 €kWh
- Stromgestehungskosten in sonnenreicheren Gegenden<0,1 €kWh



Aufteilung der Kosten - Systemebene

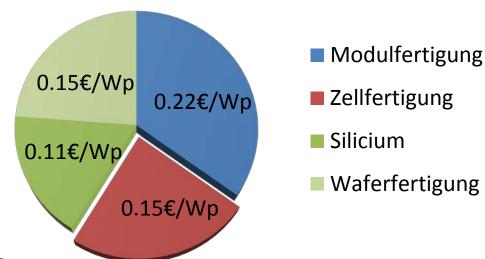
- Anteil der Systemkosten (Wechselrichter, Aufständerung, Kabel...) steigt an
- Höhere Modulwirkungsgrade reduzieren die Systemkosten, da dies umgekehrt mit der Leistung skalieren

	BOS (inkl. Inverter)	Modul	
2006	30 %	70 %	
2012	50 %	50 %	



Aufteilung der Kosten - Modulebene

- Für die Zellfertigung stehen nur 25 % der Modulkosten zur Verfügung
- Wirkungsgrad der Zelle reduziert die Gesamtkosten dramatisch



Ziel für zukünftige Zelltechnologien

- 1. Höhere Wirkungsgrade
- Reduzierung der Material- und Prozesskosten

Agenda

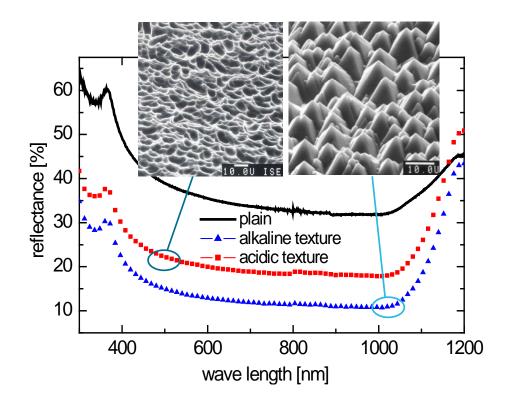
- Aktuelle Status der Photovoltaik
- Siliciumsolarzellen: State-of-the-art Technologie
- Technologien zur Steigerung des Wirkungsgrades
- Zusammenfassung

Saw damage removal / texture and cleaning

Prozessfluss

Sägeschaden entfernen Reinigen





Saw damage removal / Dopant source texture and cleaning Deposition of dopant source Phosphorus Silicate Glass (PSG) n-typ emitter Prozessfluss p-typ Si-wafer schaden entfernen

Saw damage removal / texture and cleaning

Deposition of dopant source

Diffusion

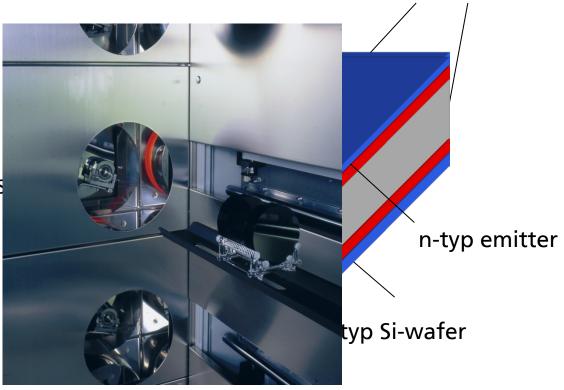
Phosphorus Silicate Glass (PS

Prozessfluss









Dopant source

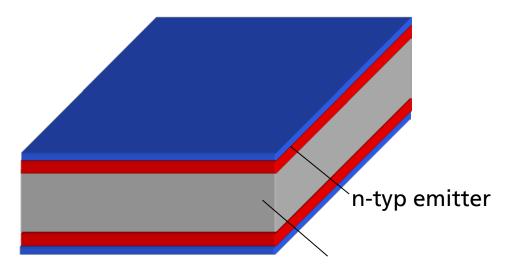
Saw damage removal /

texture and cleaning

Deposition of dopant source

Diffusion

Removal of PSG and cleaning



p-typ Si-wafer

Prozessfluss











Saw damage removal /

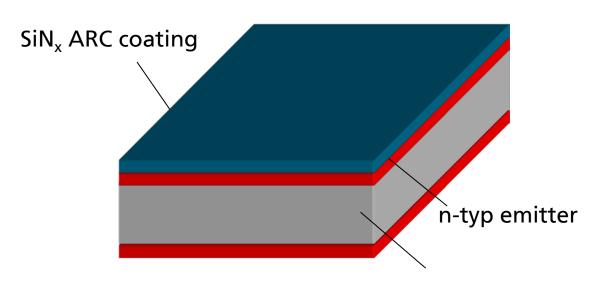
texture and cleaning

Deposition of dopant source

Diffusion

Removal of PSG and cleaning

Deposition of SiN_x ARC-coating



Prozessfluss











p-typ Si-wafer



front contacts (Ag) Saw damage removal / texture and cleaning Deposition of dopant source SiN_x ARC coating Diffusion Removal of PSG and cleaning Deposition of SiN_x ARC-coating Screen printing of contacts n-typ emitter (Al, AgAl, Ag) contact pads (AgAl) rear contact (Al) p-typ Si-wafer Prozessfluss schaden entfernen Reinigen

Saw damage removal / texture and cleaning

Deposition of dopant source

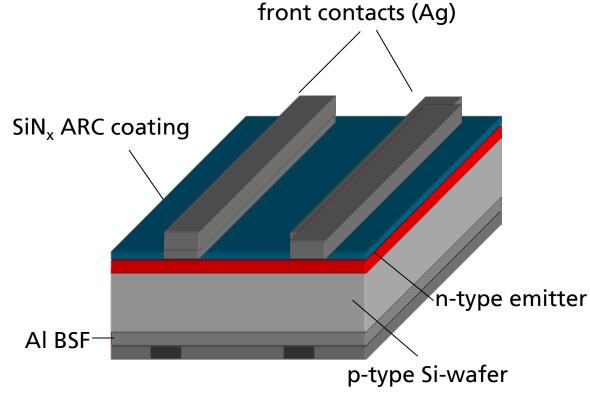
Diffusion

Removal of PSG and cleaning

Deposition of SiN_x ARC-coating

Screen printing of contacts (Al, AgAl, Ag)

Contact firing

















Saw damage removal / texture and cleaning

Deposition of dopant source

Diffusion

Removal of PSG and cleaning

Deposition of SiN_x ARC-coating

Screen printing of contacts (Al, AgAl, Ag)

Contact firing

Laser edge isolation









Phosphorus Silicate-

Glass (PSG)

Al-BSF







front contacts (Ag)



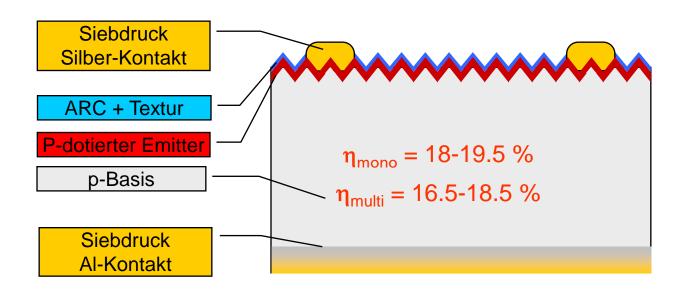






Silicium Solarzellen

Zelltechnologie – Stand der Technik



Prozessfluss → 8 Schritte

















Agenda

- Aktuelle Status der Photovoltaik
- Siliciumsolarzellen: State-of-the-art Technologie
- Technologien zur Steigerung des Wirkungsgrades
- Zusammenfassung

Technologien zur Steigerung des Wirkungsgrades

Ziele:

- Stromgestehungskosten senken
 - Weniger Materialverbrauch
 - Höhere Wirkungsgrade

Reduzierung der Stromgestehungskosten meint Reduzierung der

- Materialkosten, Lohnkosten, Capex,
- Aber auch: Rekombinations-, Widerstands- und optischen Verluste
- → Reduzierung der Verluste

Was sind die Hauptverlust der Zelle?

Stopfen der Löcher im Eimer

Um zu wissen welches Loch man stopfen muss, muss man die Verluste kennen

→ Analyse der Verlustmechanismen notwendig



Was sind die Hauptverlust der Zelle?

Analyse der Verlustströme

j_{max} = theoretisches Maximum für eine bestimmte Waferdicke

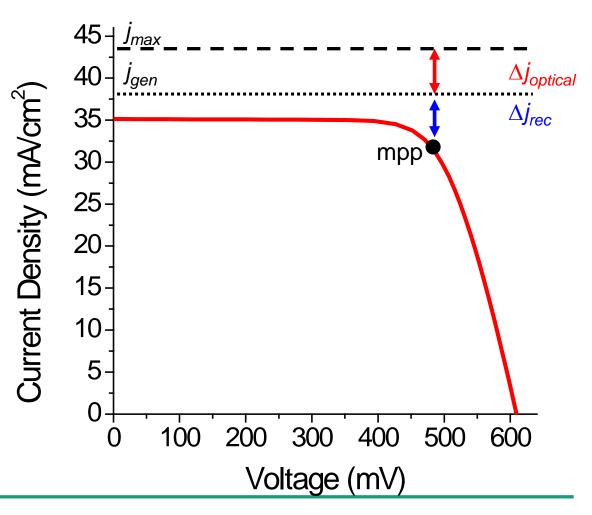
j_{gen}= Absorbierter Photonenstrom

Optischer Verlust

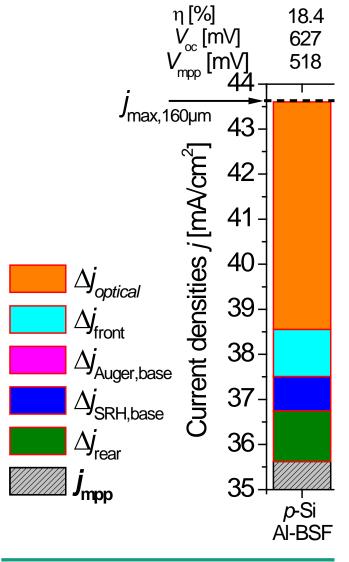
$$= j_{max} - j_{gen}$$

Rekombination am Punkt maximaler Leistung (MPP)

$$= j_{gen} - j_{mpp}$$



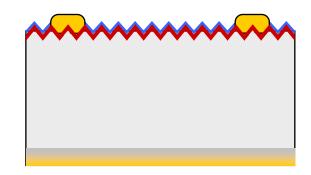
AI-BSF P-Typ Silicium



Optische Verluste

$$j_{max, 160 \, \mu m} = 43.6 \, mA/cm^2$$

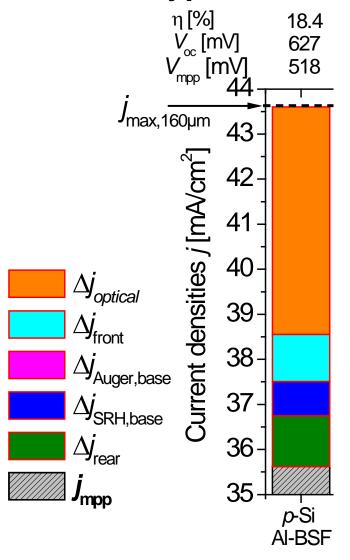
Optischer Verlust
$$\Delta j_{optical} = j_{max, 160 \mu m} - j_{gen}$$



Hauptverluste:

- → Abschattung
- → Schlechte interne Reflexion

AI-BSF P-Typ Silicium

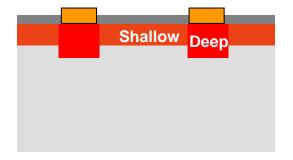


Rekombinationsverluste



Rekombination auf der Vorderseite: Hochdotierter Emitter um Kontaktierung mittels Siebdruck zu ermöglichen

Zellentwicklung Selektiver Emitter



 $\Delta \eta = 0.3\% \dots 0.5\%$

Selektiver Emitter:

Hochdotierte tiefe Diffusion unter den Kontakten :

- → Gute Kontaktierbarkeit
- → Gute Abschirmung

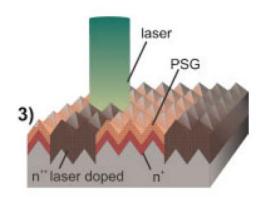
Geringere Dotierung zwischen den Fingern:

→ Geringe Rekombination

Zellentwicklung

Selektiver Emitter

add-on laser doping



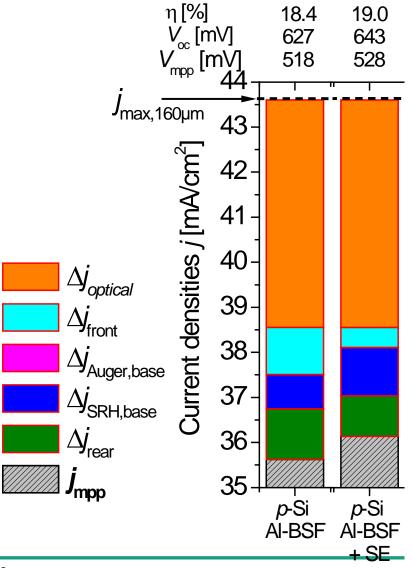
Röder et al., Prog. Photovolt. 18, p. 505 (2010)

Different technological options:

- Laser over-doping from PSG
- Chemical etch-back of heavy emitter diffusion
- Implanted emitter
- Diffusion through a thin oxide opened in the finger region
- Selective laser doping from spray-on phosphorus coating
- Printing of P-dope or phosphorusdoped silicon ink
- Laser-chemical processing



AI-BSF P-Typ Silicium + Selektiver Emitter



Optimierter Vorderseitenemitter:

→ Geringer Rekombination an der Vorderseite

Nächstes Leck:

Rekombination an der Rückseite und optische Verluste

→ Ersetzten des Al-BSF durch dielektrische Passivierung der Rückseite

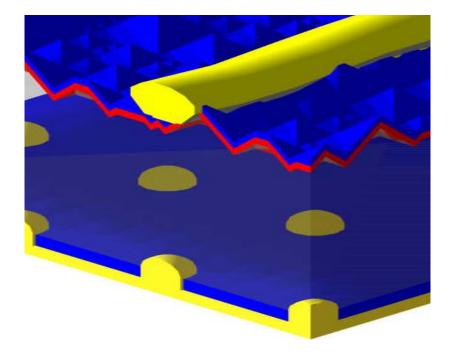
Dielektrische Rückseitenpassivierung

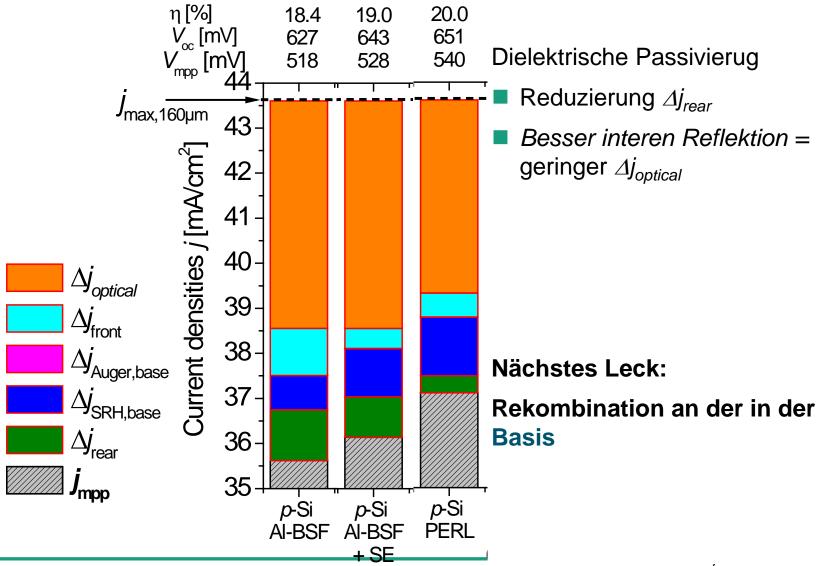
Lokale Kontakte

Ersetzen der ganzflächigen Metallkontaktierung durch dielektische Passivierung und lokale Kontakte

Vorteile:

- Geringer Rekombination
- Bessere interne Reflexion

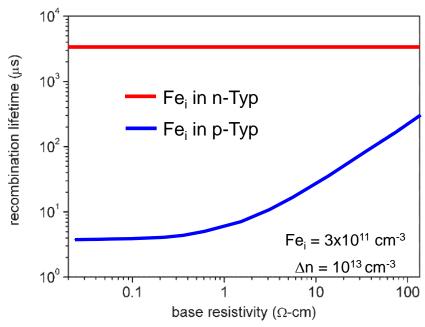




n-Typ versus *p*-Typ Silicium

Lebensdauer, Einfangsquerschnitt

- Verunreinigungen im Silicium reduzieren die Ladungsträgerlebensdauer
- Die meisten Verunreinigungen haben einen größeren Einfangsquerschnitt für Elektronen als für Löcher

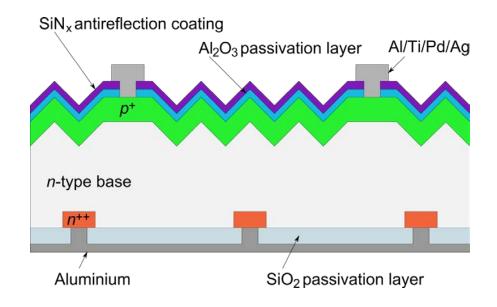


→ n-Typ Silicium weist eine sehr hohe Toleranz gegenüber Verunreinigungen auf

Laborergebnisse

- Alle Oberflächen passiviert
- Lokale Metallkontakte

	$V_{\rm oc}$	$J_{ extsf{sc}}$	FF	η
	[mV]	[mA/cm ²]	[%]	[%]
Best cell	705	41.1	82.5	23.9*



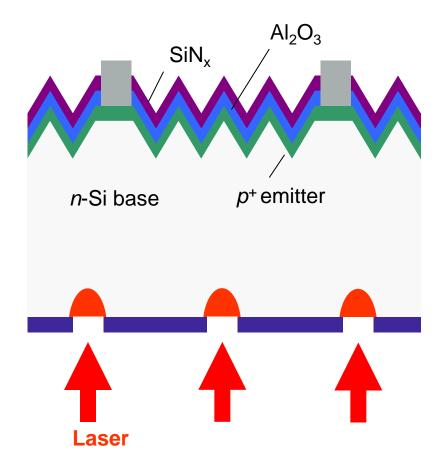
*Confirmed at Fraunhofer ISE CalLab

ap = aperture area
(= bus bar included in illuminated area)

Benick et al., APL 92 p. 253504 (2008) Glunz et al., IEEE PVSC 2010

Industrielle Umsetzung

 Lokale Laserdotierung aus der dielektrischen Passivierung heraus



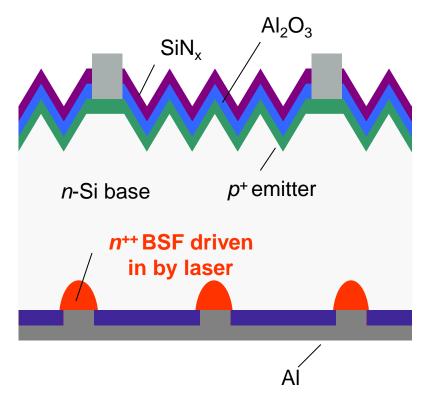
D. Suwito et al., IEEE TED (2010)

Industrielle Umsetzung

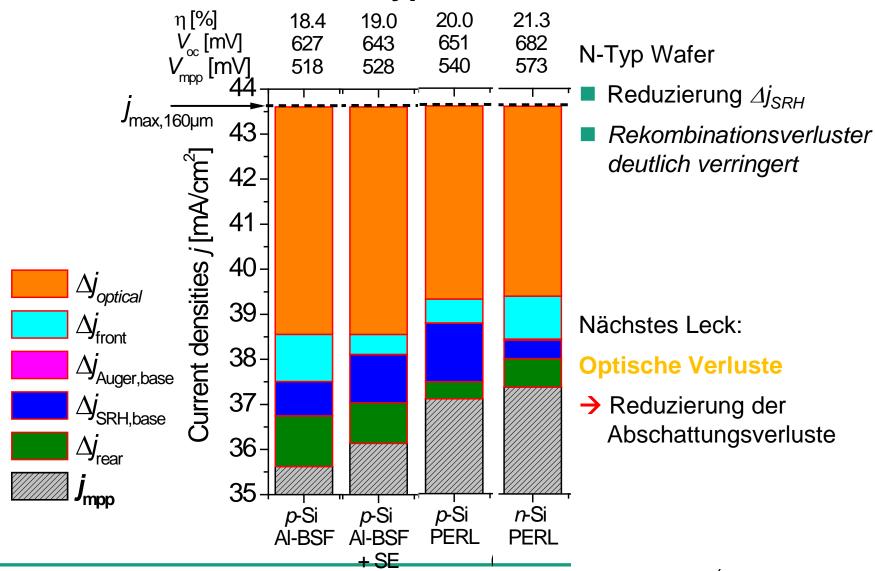
 Lokale Laserdotierung aus der dielektrischen Passivierung heraus

	$V_{\rm oc}$	$J_{ extsf{sc}}$	FF	η
	[mV]	[mA/cm ²]	[%]	[%]
Best cell	701	39.8	80.1	22.4*

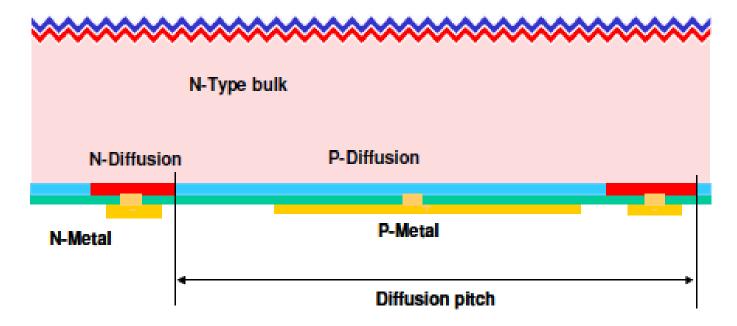
^{*}Confirmed at Fraunhofer ISE CalLab



D. Suwito et al., IEEE TED (2010)



Sunpower



- Alle Oberflächen passiviert
- Keine Abschattungsverluste auf der Vorderseite
- → Hohe Ströme und Spannungen

Sehr komplexe Prozessierung

Strukturierung

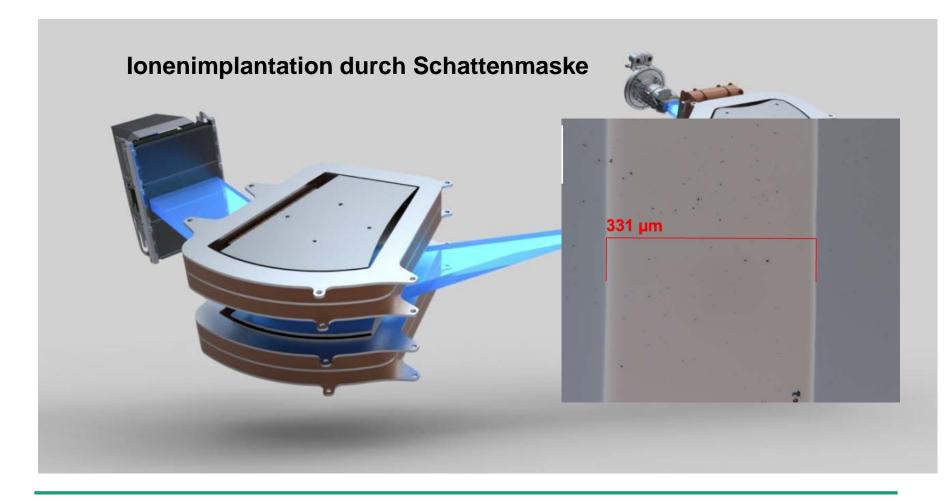
Diffussion mit dielektrischer Maskierung (5 Prozessschritte)

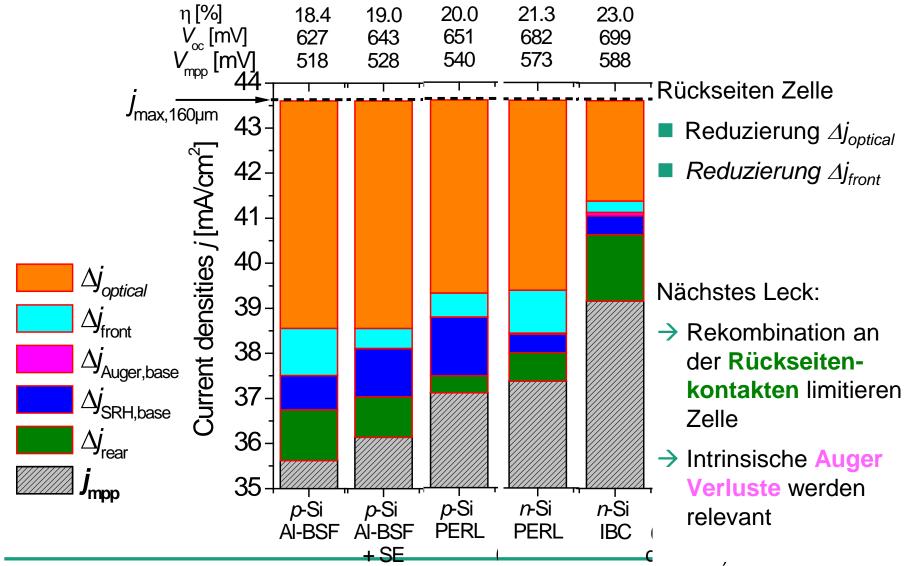


■ Ziel → 1 Prozessschritt



Strukturierung

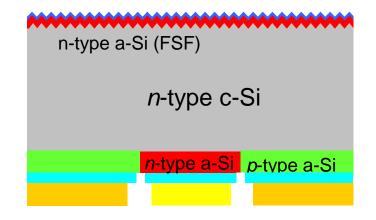




Passivierte Kontakte

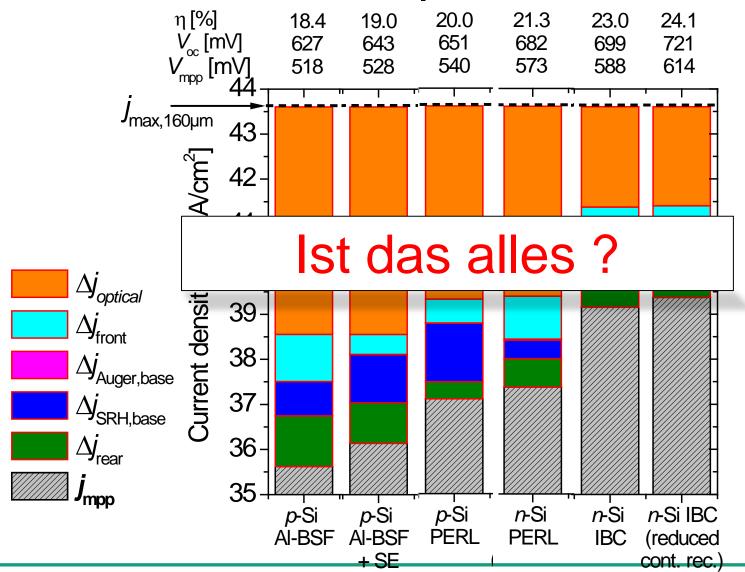
- Heterübergänge sind selektive Kontakte
- Rekombination an den Kontakten wird verhindert
- Im Labor bereits sehr gute Ergebnisse erzielt (z.B. LG Electronics²)

² Choi et al., 2nd npv workshop 2012



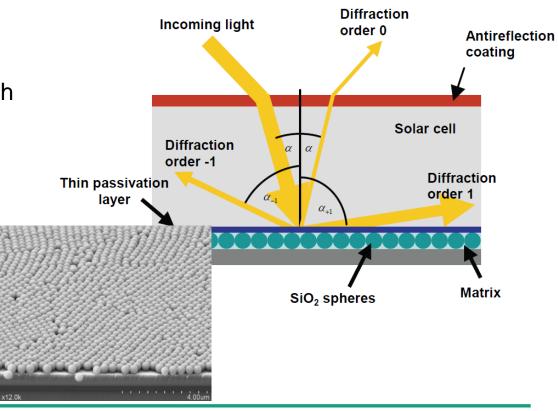
	$V_{\rm oc}$	$J_{ m sc}$	FF	η
	[mV]	[mA/cm ²]	[%]	[%]
<i>n</i> -type FZ-Si 4 cm ²	723	41.8	77.4	23.4

Rückseitenkontaktzelle mit passivierten Kontakten



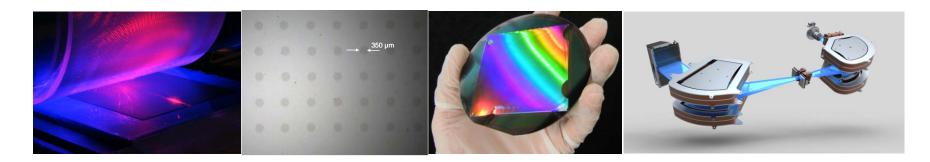
Ultra-light trapping for the next generation cells Beugende Rückseitenstrukturen für Ultradünne Zellen

- Reduzierung der Siliciumkosten durch Verwendung ultradünner Wafer (<50 µm)
- → Lichtabsorption muss deutlich verbessert werden
- Beugende Strukturen führen zu deutlich höheren Lichtwegen als klassische Strukturen

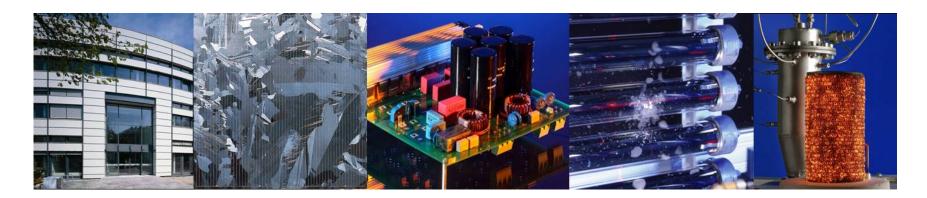


Zusammenfassung

- Siliciumsolarzellen dominieren den Markt seit über 30 Jahren.
- Relevanter Beitrag zur Stromenstehung in Deutschland
- Technologische Weiterentwicklung erlauben deutliche Wirkungsgradsteigerungen
- Stromgestehungskosten für die Silicium PV werden weiter sinken



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE

Dr. Martin Hermle

martin.hermle@ise.fraunhofer.de